

TAESUNG CERAMIC BRUSH

태성의 세라믹 브러시는 뛰어난 연마력을 갖춘 세라믹 연마재로서 Hole Plugging 잉크연마, Prepreg Resin의 연마 및 PCB 기판 표면 연마에서 우수한 성능을 발휘함



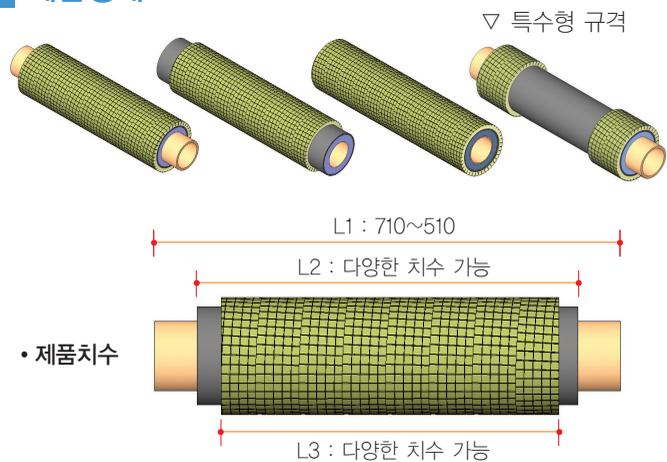
제품특징

- New Bonding Method에 의해 제조되어 Ceramic의 강도 우수(수명 향상)
- 홀 플러깅 잉크연마 능력이 탁월
- 균일한 조도값 형성

주요용도

주 용도로 홀 주변에 과도하게 충전된 플러깅 잉크 제거 시, 낮은 부하율로도 뛰어난 연삭력으로 잉크를 제거하여 scale 변화가 거의 없으며, 굴곡에 대한 추종성이 없어 딤플현상을 효과적으로 제거.

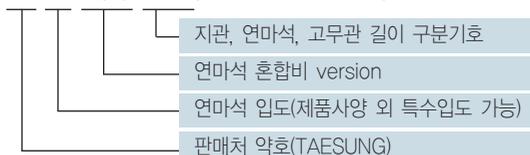
제품형태



제품사양

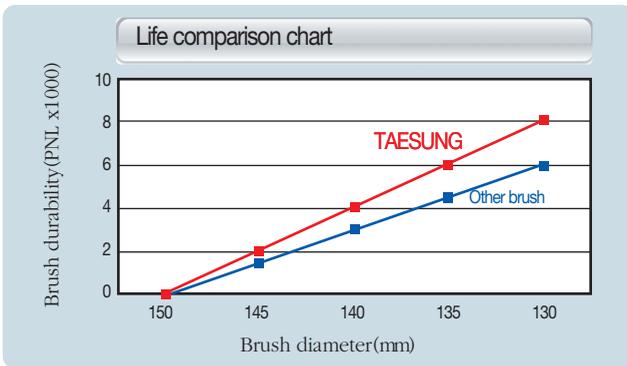
MINERAL TYPE	MODEL No.	GRIT	Remark
GREEN SILICON CARBIDE	TS 01-A-SOO	#320	standard
	TS 02-A-SOO	#400	
	TS 03-A-SOO	#600	
	TS 04-A-SOO	#800	
	TS 05-A-SOO	#1200	
	TS 15-A-SOO	#1500	special
TS 20-A-SOO	#2000		

- 제품규격 : OD 150 X ID 76.2 X L710(610)
- 제품코드 : TS 01 A(B) SOO(L00 /M00/ S00)



World's Best Products

제품수명

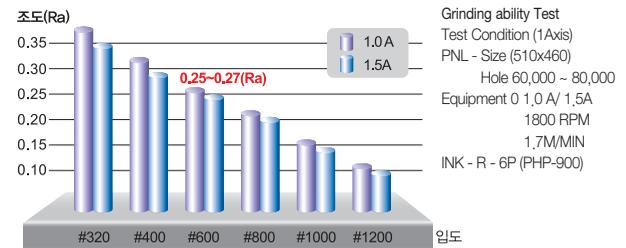
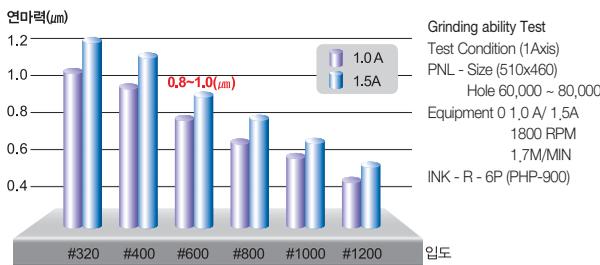


• Durability (수명)

TAESUNG CERAMIC BRUSH는 태성만의 새로운 BONDING SYSTEM으로 긴 수명을 보장하며, 브러시의 원가절감과 브러시 교체시간을 단축하는 편리성을 제공합니다.

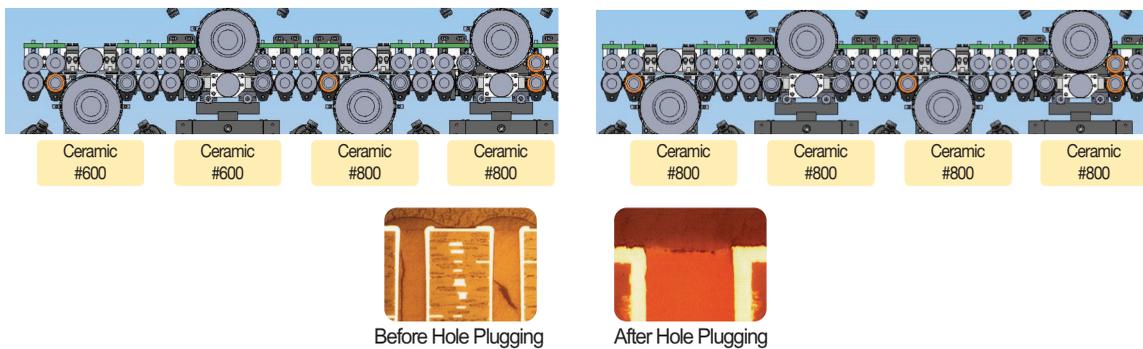
- Test 조건(1Axis) : PNL size(510x406mm)
HOLE 6만~8만(MLB)
- 설비조건 : 1.0A , 1800RPM , 1.7m/min

입도별 연마력 비교 / 조도 비교



CERAMIC BRUSH 적용라인

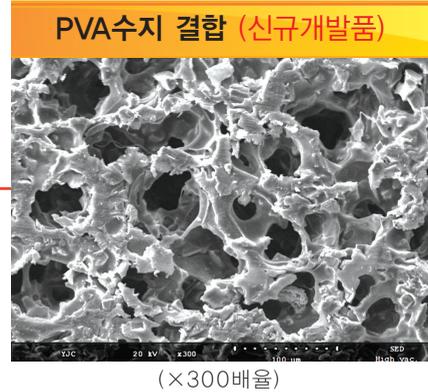
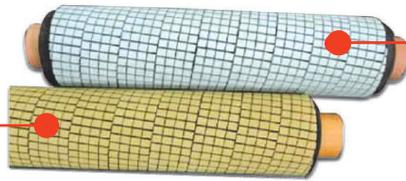
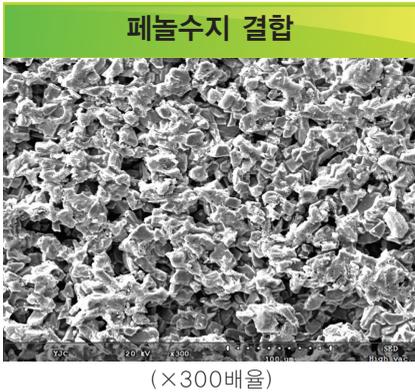
HOLE PLUGGING LINE (BGA, FC)



D/F PRE TREATMENT / After Cu Plating

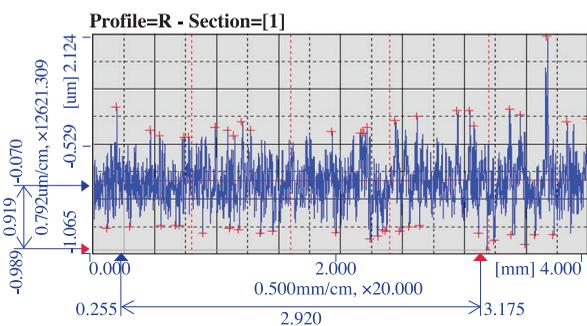


태성 세라믹브러쉬 종류

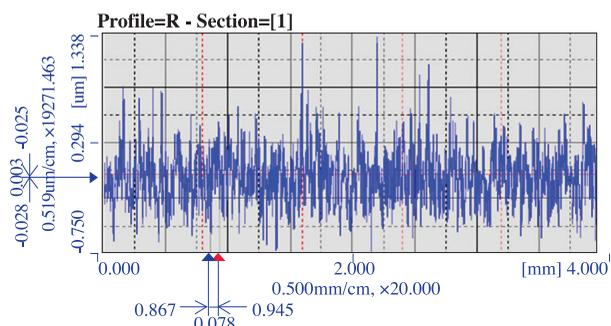


태성 브러쉬 비교		TS-03B	TS-03VA
결합제 종류		페놀수지 TYPE	PVA TYPE
연마제 입도		#600	#600
연마석 밀도 (g/cm ³)		1.45	0.8
기공 비율 (%)		43	80
연마석 압축강도 (kg/cm ²)		800	146
연마력 (μm/pass)	1.0A	0.72	0.45
	1.5A	0.83	0.54
표면 조도 (μm)	Ra	0.255	0.184
	Rz	1.785	1.273
비 고		페놀수지 결합브러쉬는 강함결합력과 높은경도로 연마력이 강하다	다기공 구조를 갖기 때문에 연마칩 배출이 용이하며 연마석에 약간의 탄성을 보유하고 있어 표면조도 우수함.

표면조도 비교



Parameter	Result	Parameter	Result
Ra	0.255 μm	Ra	1.785 μm
Ry	2.426 μm	Sm[10.000%]	0.037 μm
Rt	3.404 μm	S	0.015 μm



Parameter	Result	Parameter	Result
Ra	0.184 μm	Ra	1.273 μm
Ry	1.654 μm	Sm[10.000%]	0.033 μm
Rt	1.989 μm	S	0.015 μm